

2011年4月28日

2011年3月期 決算説明会

代表取締役社長
久芳 徹夫

京セラ株式会社

本日の説明内容

1. 2011年3月期 決算概要

2. 2012年3月期 業績予想

1. 2011年3月期 決算概要

2011年3月期 決算概要（前期比）

（単位：億円）

	2010年3月期		2011年3月期		増 減	
	金 額	売上高比 (%)	金 額	売上高比 (%)	金 額	率 (%)
売 上 高	10,738	100.0	12,669	100.0	1,931	18.0
営 業 利 益	639	5.9	1,559	12.3	920	144.2
税引前当期純利益	608	5.7	1,723	13.6	1,115	183.5
当社株主に帰属する 当期純利益	401	3.7	1,224	9.7	823	205.4
希薄化後1株当たり当社株主に 帰属する当期純利益（円）	218.47	-	667.23	-	448.76	-
設 備 投 資 額	379	3.5	707	5.6	328	86.6
減 価 償 却 費	606	5.6	598	4.7	-8	-1.3
研 究 開 発 費	499	4.6	495	3.9	-4	-0.9
平 均 為 替 レ ー ト	対ドル： 93円	対ユーロ： 131円	対ドル： 86円	対ユーロ： 113円		
為替変動による 影響額(前期比)	売上高	約-490億円	約-680億円			
	税引前 当期純利益	約-135億円	約-280億円			

2011年3月期 事業セグメント別売上高

(単位:億円)

■ 事業セグメント	2010年3月期		2011年3月期		増 減	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	率 (%)
■ ファインセラミック部品関連事業	531	5.0	763	6.0	232	43.8
■ 半導体部品関連事業	1,405	13.1	1,747	13.8	342	24.3
■ ファインセラミック応用品関連事業	1,570	14.6	1,976	15.6	406	25.9
■ 電子デバイス関連事業	1,999	18.6	2,426	19.2	427	21.4
部品事業 計	5,505	51.3	6,912	54.6	1,407	25.6
■ 通信機器関連事業	1,891	17.6	2,252	17.8	361	19.1
■ 情報機器関連事業	2,324	21.6	2,399	18.9	75	3.2
機器事業 計	4,215	39.2	4,651	36.7	436	10.3
■ その他の事業	1,246	11.6	1,394	11.0	148	11.9
調整及び消去	-228	-2.1	-288	-2.3	-60	-
売上高	10,738	100.0	12,669	100.0	1,931	18.0

全てのセグメントで増収

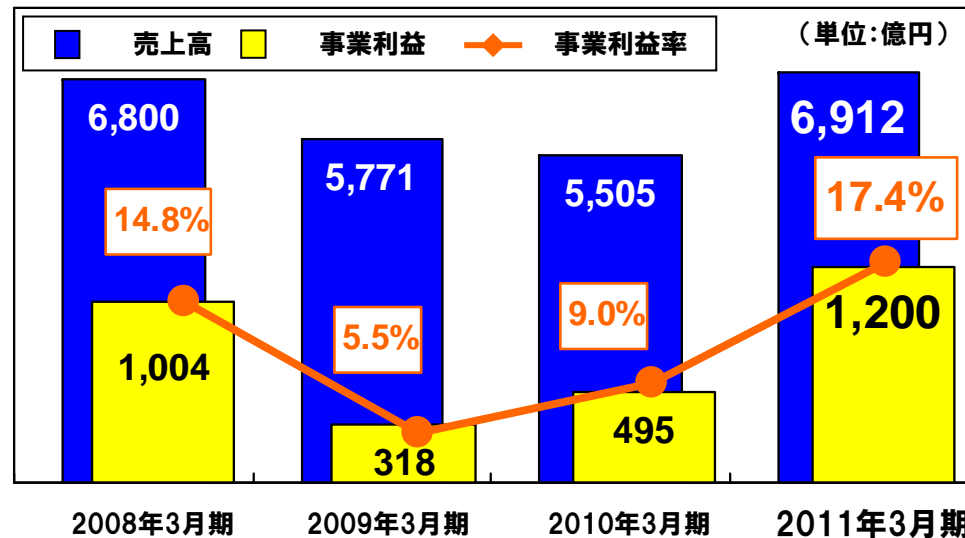
2011年3月期 事業セグメント別事業利益

(単位:億円)

■ 事業セグメント	2010年3月期		2011年3月期		増減	
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	金額	率(%)
■ ファインセラミック部品関連事業	-8	-	120	15.7	128	-
■ 半導体部品関連事業	172	12.3	373	21.4	201	116.6
■ ファインセラミック応用品関連事業	199	12.6	291	14.7	92	46.3
■ 電子デバイス関連事業	132	6.6	416	17.2	284	214.8
部品事業 計	495	9.0	1,200	17.4	705	142.2
■ 通信機器関連事業	-147	-	21	0.9	168	-
■ 情報機器関連事業	221	9.5	259	10.8	38	17.0
機器事業 計	74	1.7	280	6.0	206	279.7
■ その他の事業	68	5.4	96	6.9	28	42.6
事業利益 計	637	5.9	1,576	12.4	939	147.5
本社部門損益	156	-	169	-	13	7.8
持分法投資損益	-183	-	-2	-	181	-
調整及び消去	-2	-	-20	-	-18	-
税引前当期純利益	608	5.7	1,723	13.6	1,115	183.5

全てのセグメントで増益

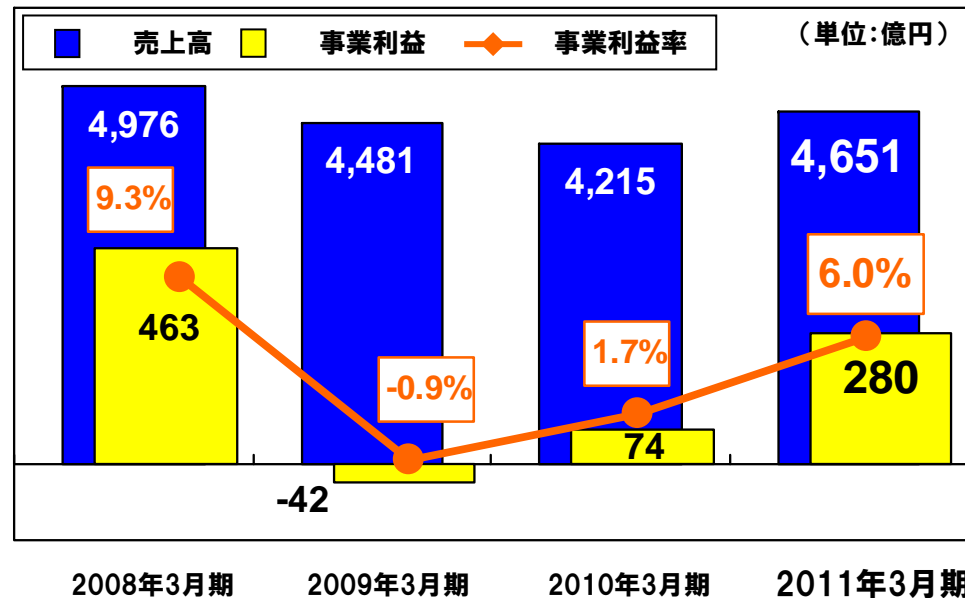
2011年3月期 決算要約（1） 部品事業



2010年3月期比 増減	
売上高	+1,407億円 (+25.6%)
事業利益	+ 705億円 (+142.2%)

- デジタルコンシューマ機器、産業機械、自動車市場等向け部品需要の増加
- 旺盛な需要に対応した積極的な生産能力の増強
- 原価低減、生産性の向上により、売上の伸びに伴い事業利益は大幅に増加
- 事業利益率は2008年3月期を上回る17.4%へ向上

2011年3月期 決算要約（2） 機器事業



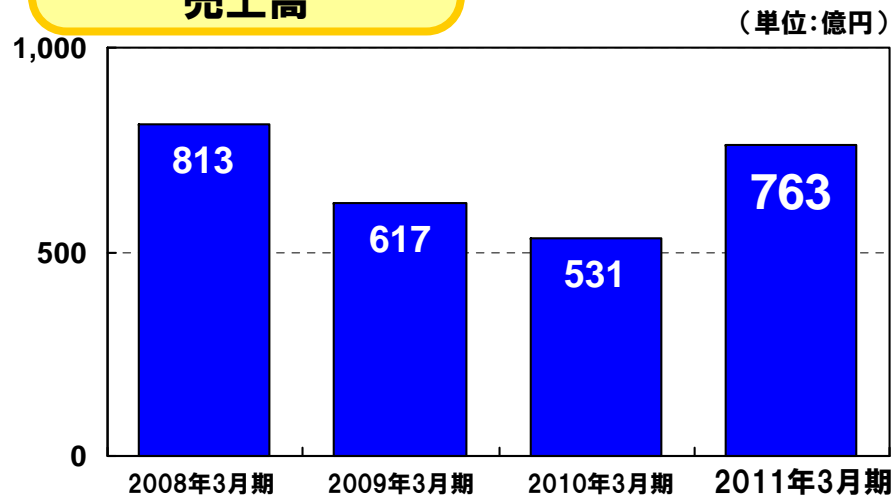
2010年3月期比 増減	
売上高	+436億円 (+10.3%)
事業利益	+206億円 (+279.7%)

- 携帯電話端末のラインナップ拡充による通信機器関連事業の売上増
- 売上増及び構造改革の効果に加え、前期に約90億円の一時損失を計上したこともあり、通信機器関連事業の利益は大幅に改善

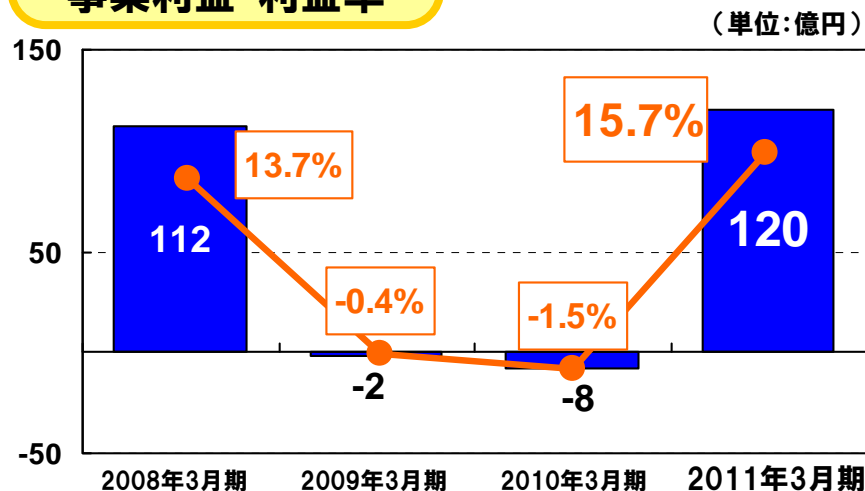
2011年3月期 事業セグメント別業績推移（1）

- ファインセラミック部品関連事業 -

売上高



事業利益・利益率



2010年3月期比 増減

売上高	+232億円 (+43.8%)
事業利益	+128億円 (黒字転換)

半導体製造装置用部品等の産業機械用部品や自動車用部品の需要増により、大幅な増収増益



半導体製造装置用部品

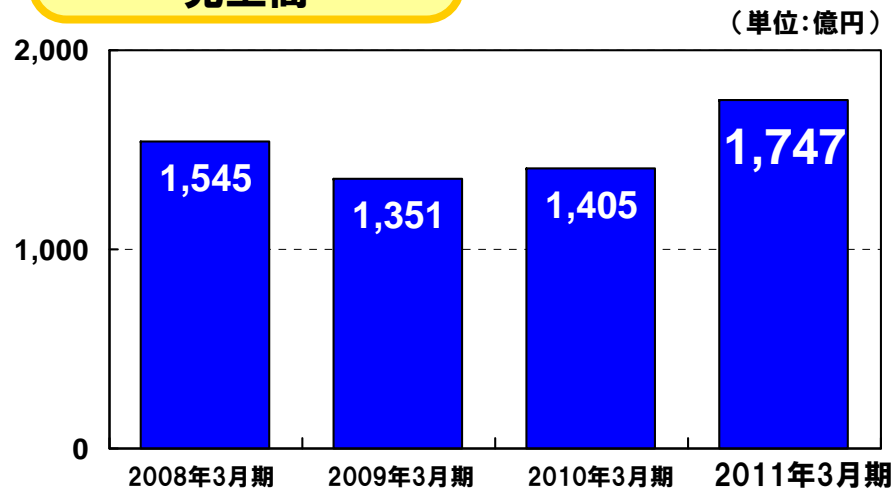


グロープラグ(自動車部品)

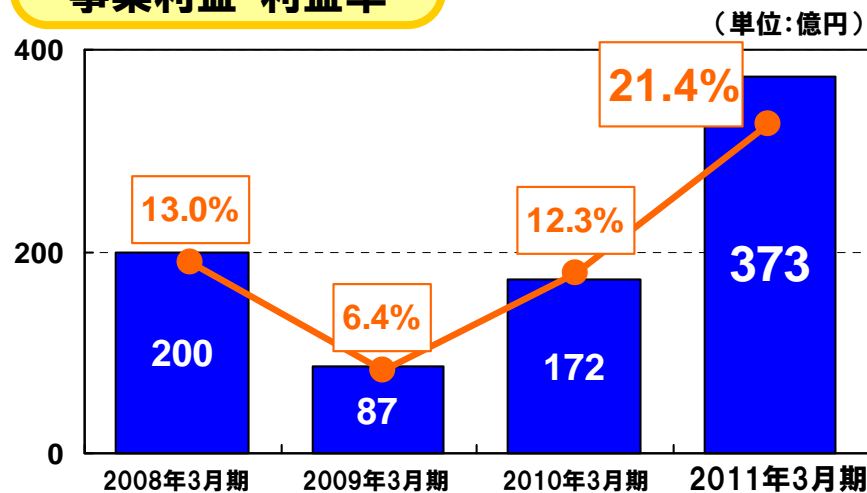
2011年3月期 事業セグメント別業績推移（2）

- 半導体部品関連事業 -

売上高



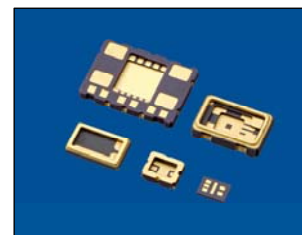
事業利益・利益率



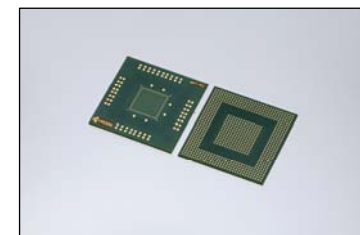
2010年3月期比 増減

売上高	+342億円 (+24.3%)
事業利益	+201億円 (+116.6%)

デジタルコンシューマ機器向けセラミックパッケージ及びサーバー／ルーター向け有機パッケージの需要増により、大幅な増収増益



水晶／SAWデバイス用セラミックパッケージ



ASIC用有機パッケージ

2011年3月期 事業セグメント別業績推移 (3)

- ファインセラミック応用品関連事業 -

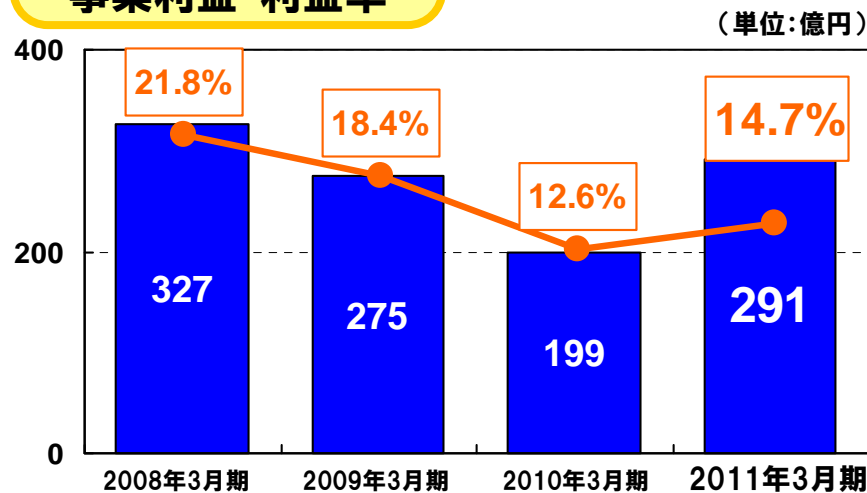
売上高



2010年3月期比 増減

売上高	+406億円 (+25.9%)
事業利益	+92億円 (+46.3%)

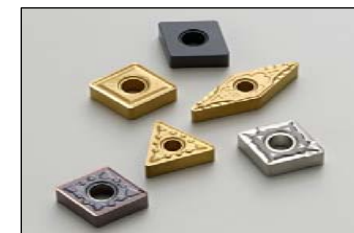
事業利益・利益率



ソーラーエネルギー事業及び自動車
関連市場向け機械工具事業の需要
増により、増収増益



住宅用太陽電池

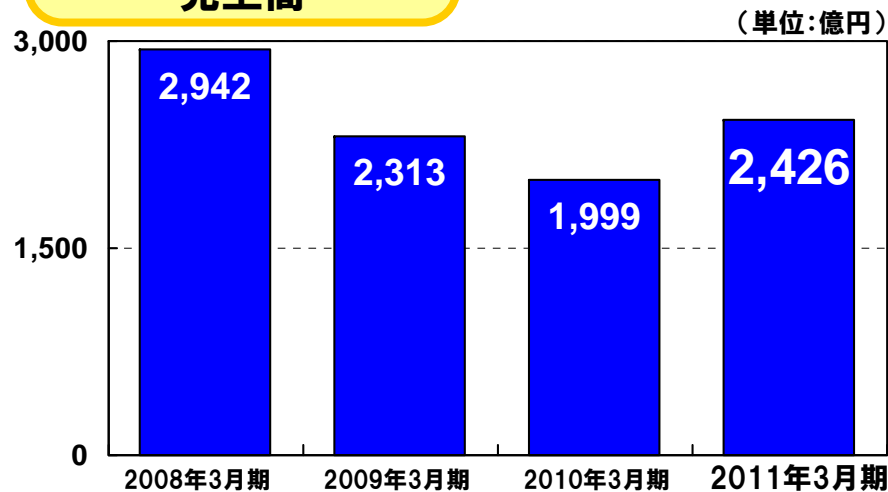


機械工具

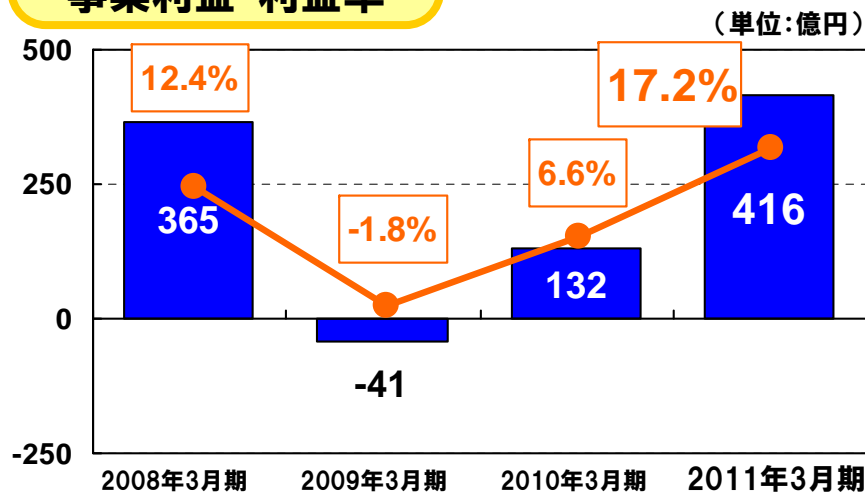
2011年3月期 事業セグメント別業績推移（4）

- 電子デバイス関連事業 -

売上高



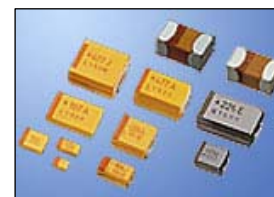
事業利益・利益率



2010年3月期比 増減

売上高	+427億円 (+21.4%)
事業利益	+284億円 (+214.8%)

- デジタルコンシューマ機器向けの部品需要増に加え、薄膜部品事業の拡大により増収
- 増収効果及び原価低減等により大幅な増益



タンタルコンデンサ

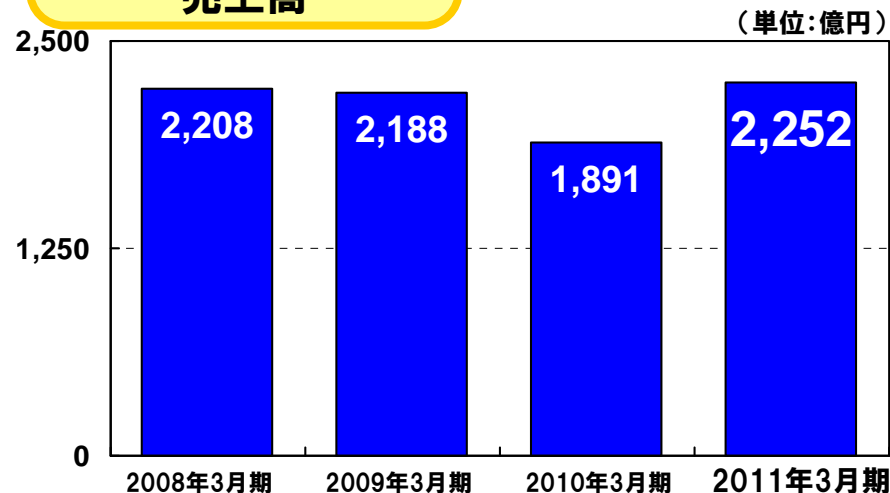


液晶ディスプレイ/タッチパネル

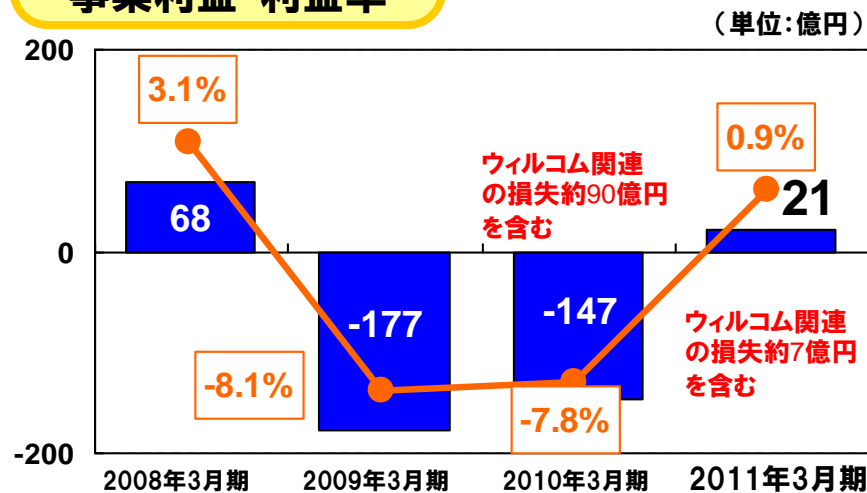
2011年3月期 事業セグメント別業績推移（5）

- 通信機器関連事業 -

売上高



事業利益・利益率



2010年3月期比 増減

売上高	+361億円 (+19.1%)
事業利益	+168億円 (黒字転換)

- 海外市場での新製品投入による販売拡大及びシェアアップ、並びに国内市場での携帯電話端末やPHS端末の販売増により増収
- 増収及び前期に進めた事業構造改革の効果により、増益



Qwertyキー端末



タッチパネル式スマートフォン



簡単ケータイ

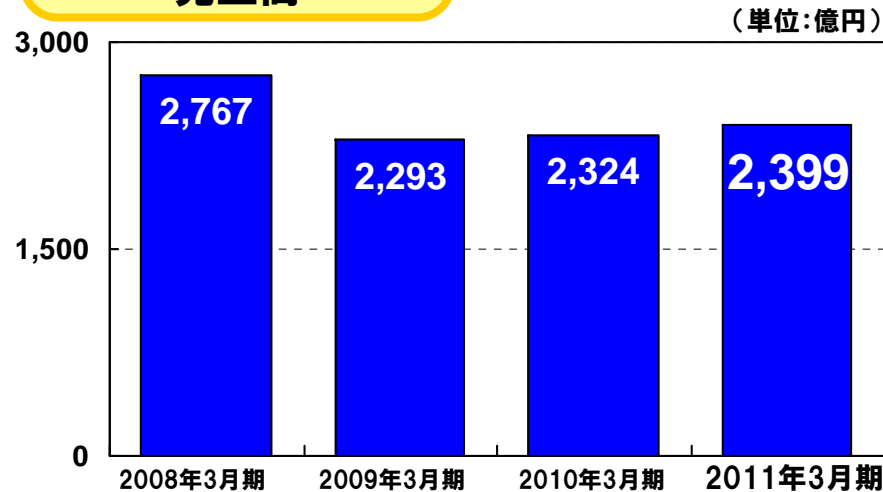


PHS端末

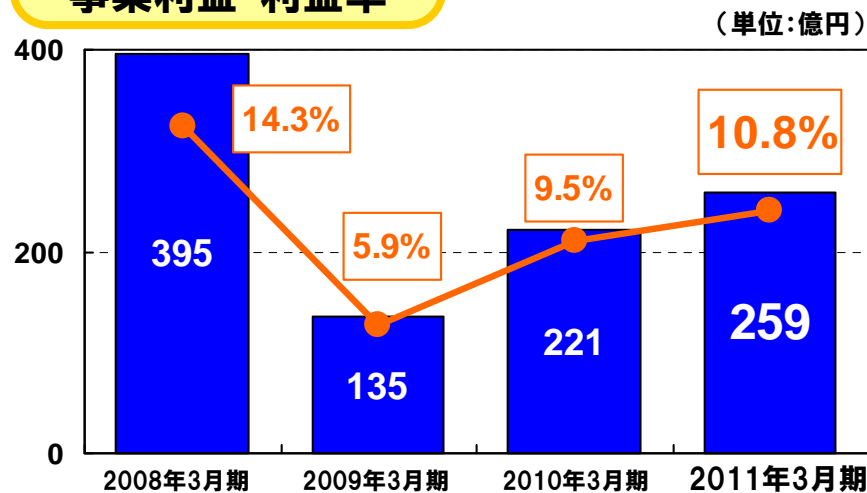
2011年3月期 事業セグメント別業績推移（6）

- 情報機器関連事業 -

売上高



事業利益・利益率



2010年3月期比 増減

売上高	+75億円 (+3.2%)
事業利益	+38億円 (+17.0%)

カラープリンターや中・高速MFP等の高付加価値製品の販売増及び消耗品の売上増により、増収増益



カラープリンター



カラー複合機

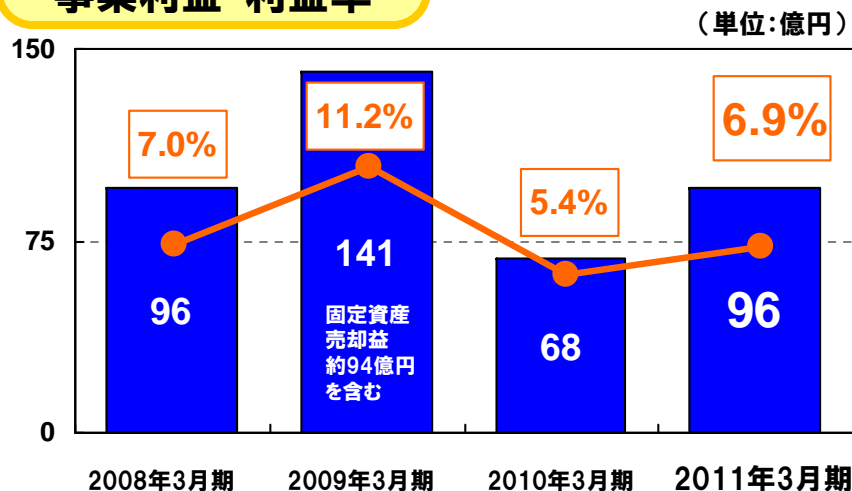
2011年3月期 事業セグメント別業績推移 (7)

- その他の事業 -

売上高



事業利益・利益率



2010年3月期比 増減

売上高	+148億円 (+11.9%)
事業利益	+28億円 (+42.6%)

京セラコミュニケーションシステムの
ICT事業の拡大及び京セラケミカルの
半導体封止材料等の売上増加により、
増収増益



ITマネジメントセンター (ICT事業)



半導体封止材料

2. 2012年3月期 業績予想

2012年3月期 事業環境見通し

国内市場

- 前半は、東日本大震災の影響による原材料等の調達及び電力供給問題等により、各社の国内での生産活動の低迷が予想される
- 復興への取り組みに伴い、環境エネルギー製品や、デジタルコンシューマ機器及び自動車関連市場向けの部品需要の増加を見込む

海外市場

- 新興国を中心に、デジタルコンシューマ機器、自動車関連市場の堅調な需要の増加を予想
- 米国をはじめとした環境エネルギー市場の伸びを見込む

2012年3月期 業績予想

(単位:億円)

	2011年3月期		2012年3月期 予想		増 減	
	金 額	売上高比 (%)	金 額	売上高比 (%)	金 額	率 (%)
売 上 高	12,669	100.0	13,600	100.0	931	7.3
営 業 利 益	1,559	12.3	1,680	12.4	121	7.7
税引前当期純利益	1,723	13.6	1,800	13.2	77	4.4
当社株主に帰属する 当期純利益	1,224	9.7	1,120	8.2	-104	-8.5
希薄化後1株当たり当社株主に 帰属する当期純利益(円)	667.23	-	610.30	-	-56.93	-
設 備 投 資 額	707	5.6	800	5.9	93	13.2
減 価 償 却 費	598	4.7	700	5.1	102	17.1
研 究 開 発 費	495	3.9	540	4.0	45	9.1
平 均 為 替 レ ー ト	対ドル: 86円	対ユーロ: 113円	対ドル: 81円	対ユーロ: 115円		
為替変動による 影響額(前期比)	売上高	約-680億円	約-240億円			
	税引前 当期純利益	約-280億円	約 -40億円			

(注) 2012年3月期業績予想の希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益は、2011年3月期の希薄化後の期中平均発行済株式数を用いて算出しています。
最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。

2012年3月期 事業セグメント別売上高予想

(単位:億円)

■ 事業セグメント	2011年3月期		2012年3月期 予想		増 減	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	率 (%)
■ ファインセラミック部品関連事業	763	6.0	860	6.3	97	12.8
■ 半導体部品関連事業	1,747	13.8	1,900	14.0	153	8.8
■ ファインセラミック応用品関連事業	1,976	15.6	2,170	16.0	194	9.8
■ 電子デバイス関連事業	2,426	19.2	2,550	18.7	124	5.1
部品事業 計	6,912	54.6	7,480	55.0	568	8.2
■ 通信機器関連事業	2,252	17.8	2,320	17.0	68	3.0
■ 情報機器関連事業	2,399	18.9	2,620	19.3	221	9.2
機器事業 計	4,651	36.7	4,940	36.3	289	6.2
■ その他の事業	1,394	11.0	1,470	10.8	76	5.5
調整及び消去	-288	-2.3	-290	-2.1	-2	-
売上高	12,669	100.0	13,600	100.0	931	7.3

2012年3月期 事業セグメント別事業利益予想

(単位:億円)

■ 事業セグメント	2011年3月期		2012年3月期 予想		増 減	
	金 額	利益率 (%)	金 額	利益率 (%)	金 額	率 (%)
■ ファインセラミック部品関連事業	120	15.7	160	18.6	40	33.7
■ 半導体部品関連事業	373	21.4	400	21.1	27	7.1
■ ファインセラミック応用品関連事業	291	14.7	295	13.6	4	1.6
■ 電子デバイス関連事業	416	17.2	430	16.9	14	3.3
部品事業 計	1,200	17.4	1,285	17.2	85	7.1
■ 通信機器関連事業	21	0.9	80	3.4	59	277.2
■ 情報機器関連事業	259	10.8	260	9.9	1	0.6
機器事業 計	280	6.0	340	6.9	60	21.6
■ その他の事業	96	6.9	70	4.8	-26	-27.5
事業利益 計	1,576	12.4	1,695	12.5	119	7.5
本社部門損益等	147	-	105	-	-42	-28.7
税引前当期純利益	1,723	13.6	1,800	13.2	77	4.4

2012年3月期 重点課題と取組み

グローバル競争に打ち勝ち
「高成長・高収益企業」を目指す

成長市場での事業拡大

- 環境エネルギー市場
- 情報通信市場
- 新興国市場

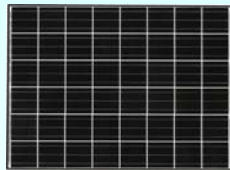
一層の経営基盤の強化

- 積極的な設備投資を実施
- 事業活動継続のための体制強化

2012年3月期 成長市場での事業拡大

環境エネルギー市場

- 太陽電池やLED関連製品等の拡販
- SOFCセルスタック、スマートセンサーの販売開始



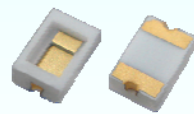
太陽電池



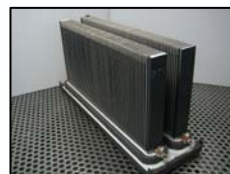
LED照明



サファイア基板



LED用セラミックパッケージ



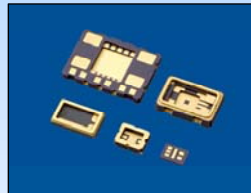
SOFCセルスタック



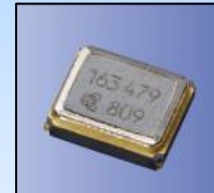
スマートセンサー

情報通信市場

- 小型、高機能部品の拡販
- スマートフォンのラインナップ拡充



水晶/SAWデバイス用
セラミックパッケージ



小型・高精度
TCXO



2画面タッチスクリーンスマートフォン

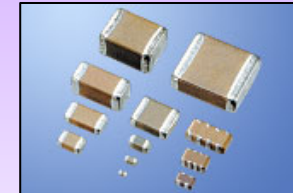
新興国市場

事業機会の獲得

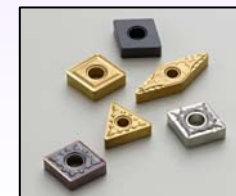
- デジタルコンシューマ機器の普及
- 一般産業機械市場の拡大



水晶振動子



セラミックコンデンサ



機械工具



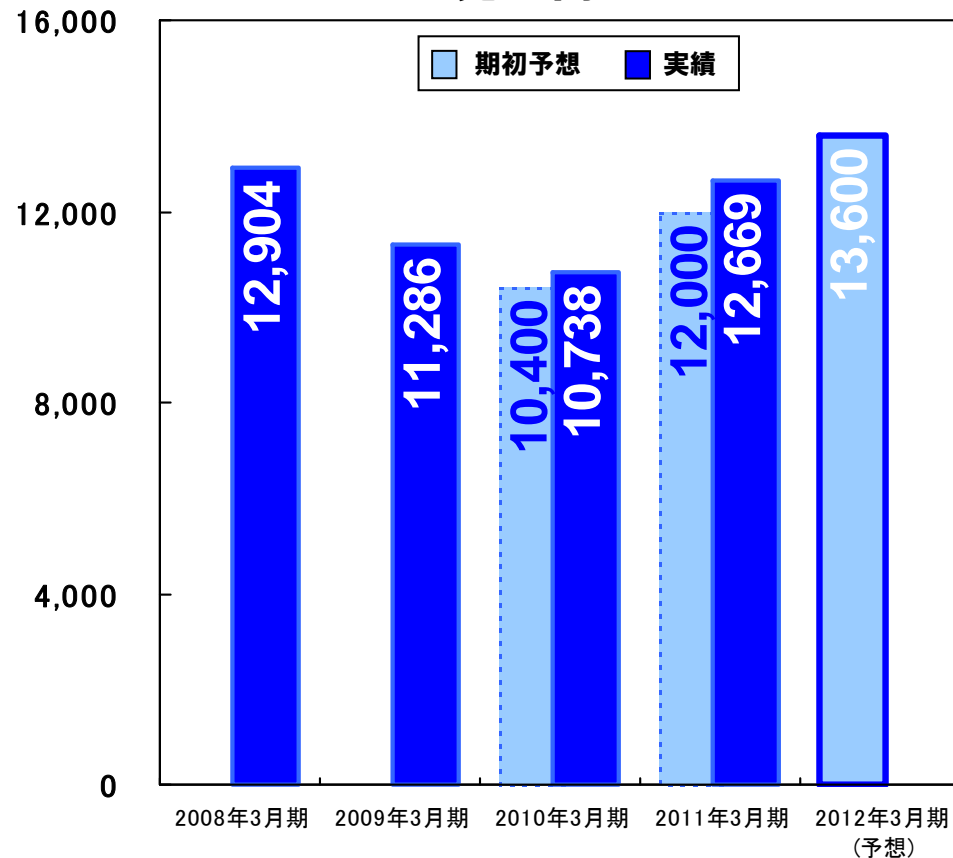
モノクロプリンター

2012年3月期 経営目標

成長の機会を捉え、過去最高の売上高を目指す

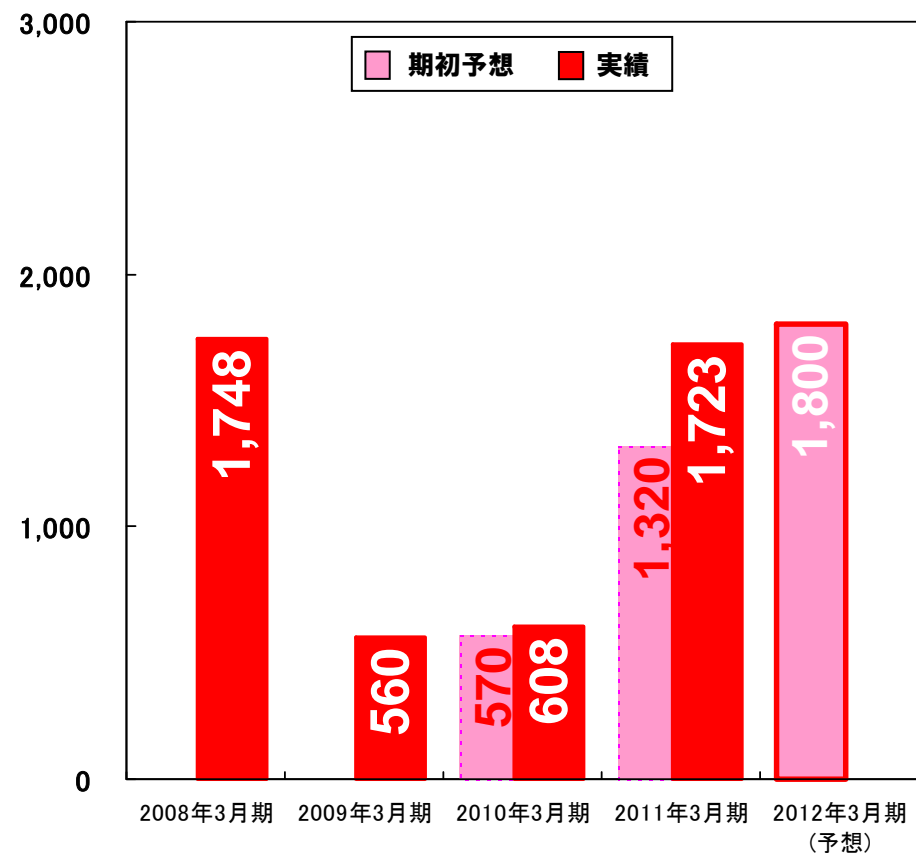
(単位:億円)

売上高



(単位:億円)

税引前当期純利益



将来予想に関する注意事項

この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。かかる将来予想に関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものであります。これらの将来予想に関する記述は、既知及び未知のリスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は以下のものを含みますが、これらに限られるものではありません。(1)当社が関連する市場における経済状況(主に、日本、北米、欧州及びアジア(特に中国))。(2)当社が事業を行なう国における経済・政治・法律面での予測し得ない条件の変化。(3)競争の激しいセラミック、半導体部品及び電子部品市場において、当社が革新的な製品を開発・生産し、品質・納期を含めて顧客の要求に沿った先進技術を投入する能力の不確実性。(4)社外委託工程や自社内製造過程で生じる遅れや不具合の発生。(5)円高、政治・経済情勢、売掛金回収リスク、製品の価格競争力の低下、輸送経費の増大、海外事業への人材配置・管理の問題、知的財産権の保護の不十分性等、輸出に影響する可能性がある要因。(6)売上高の相当な部分を構成している通貨(特に米ドル及びユーロ)の対円為替相場の変動。(7)当社の顧客の財政状態の悪化による売掛債権の回収リスク。(8)エンジニアリング・技術部門での熟練労働者の確保の不確実性。(9)機密保持及び特許権等の知的財産権の保護の確保が不十分である事態。(10)製品を製造・販売する為に必要となるライセンスの継続的確保の不確実性。(11)今後の取り組み及び現在進行中の研究開発が期待される成果を生み出さない事態。(12)買収した会社や取得した資産に関連して想定以上の統合費用が発生し、期待される収益又は事業機会が得られない事態。(13)テロ行為、疾病、紛争、自然災害の発生等、当社の市場やサプライチェーンに悪影響を与える事象。(14)製造施設その他主要な事業関連施設が存在する地域における地震等の自然災害及びそれらに付随した災害の発生。(15)国内外の環境規制強化に伴う当社の賠償責任や費用負担の増大。(16)保有する有価証券及びその他の資産の時価の変動、減損処理の発生。(17)繰延税金資産及び法人税等の不確実性。(18)会計基準の変更。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財政状態は、これらの将来予想に関する記述に明示又は黙示される将来の業績、事業活動、展開又は財政状態と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。